Flexible, vliesstoffbasierte Leiterplatten auf Basis nachwachsender Rohstoffe



future TEX

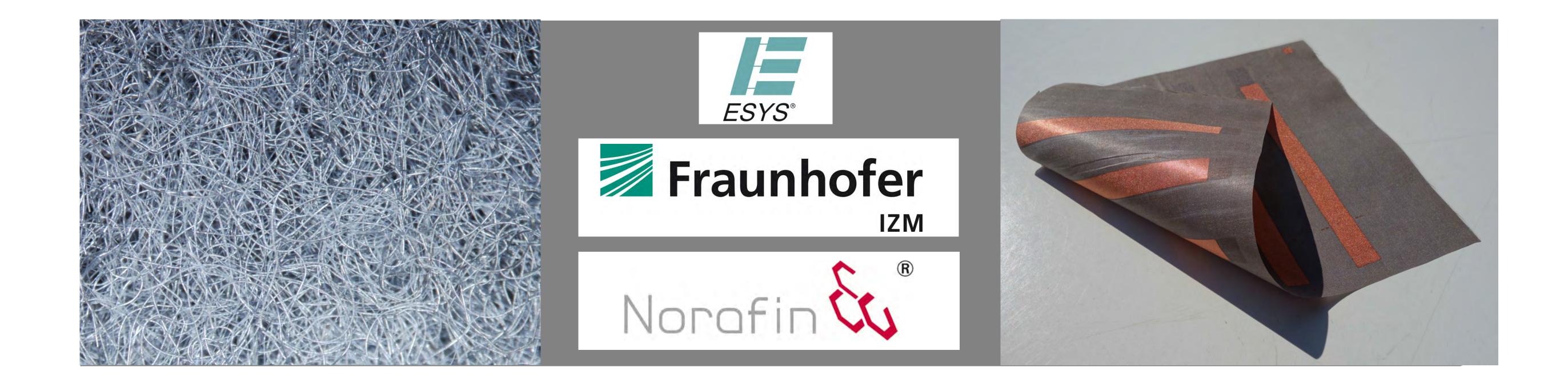
Die Akteure im Vorhaben "TexPCB" (Textile Printed Circuit Board) beschäftigen sich mit der Entwicklung und Untersuchung von neuartigen, flexiblen Materialien und Technologien zur Herstellung von textilintegrierten elektronischen Systemen.

Ziele

- Drapierbare, flexible Leiterplatten auf Vliesstoff-Basis mit Brandschutzfunktion
- Entwicklung von Basisvliesstoffen aus metallbeschichteten Fasern nachwachsender Rohstoffe
- Prozessentwicklung zur Laserstrukturierung
- Entwicklung von Designrichtlinien
- Bestückungs- und Kontaktierungsverfahren zur Integration elektronischer Komponenten
- Anwendungsszenarien für Textil integrierte Sensorik auf Basis leitfähiger Vliesstoffe

Mehrwert

- Neue Einsatzfelder für textile Sensorelektronik
- > Verfügbarkeit von preiswerten Basismaterialien und Prozesstechnologien für Smart Textiles
- Erschließung neuer Marktsegmente durch Integration bisher nicht verfügbarer Eigenschaften
- Kosteneinsparung im Vergleich zu bestehenden Lösungen
- Kompostier- bzw. Recyclierbarkeit der textilen Leiterplatten
- Nachwuchsförderung im Bereich "Elektrointegration in Textilien"









GEFÖRDERT VOM





Zukunft unternehmen!